



兆舜科技（广东）有限公司

产品说明书（TDS）

**ZS-GF-N15**

## 一、产品特点及应用

ZS-GF-N15 是以硅树脂为基材，添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成，并通过特殊工艺加工而成的胶状物。它具备优越的耐高低温性，极好的耐气候、耐辐射及优越的介电性能。导热泥无毒、无腐蚀、无味、无粘性，可在-60℃~+200℃的温度下长期保持使用时的胶状物状态。既具有优异的电绝缘性，又有优异的导热性，同时具有低油离度，耐高低温，耐水、臭氧，耐气候老化的特点，施工性能佳，使用稳定性好。可按需求捏成某种形状，填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻，快速有效地降低电子原件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。适用于功率模块、集成芯片电源模块、车用电子产品、控制器、电讯设备、计算机及其附件与散热壳体之间的填充。

## 二、典型用途

功率模块、集成芯片、电源模块、车用电子产品、控制器、电讯设备、计算机及其附件与散热壳体之间的填充。

## 三、技术参数

项目	技术指标
外观	白色或灰色胶状
比重	2.5-2.7
油离度（%）（200℃，8h）	≤0.2
挥发份（%）（200℃，8h）	≤0.5
体积电阻率（Ω·CM）	≥1.0×10 <sup>12</sup>
导热系数（w/m.k）	1.4-1.6

## 四、使用工艺

地址：东莞市中堂镇东泊村大新围路大新路二街1号  
电话：0769-8888 8312      传真：0769-8889 1019



## 兆舜科技（广东）有限公司

### 产品说明书（TDS）

- 1、方法一 批量生产操作：手搓成条切之后将小段附着于要散热的器件上
- 2、方法二 批量生产操作：模子成型小块段之后将小块附着于要散热的器件上
- 3、方法三 批量生产操作：气动点胶

按需求捏成某种形状，填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻快速有效地降低电子原件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

#### 五、注意事项

- 1、本品属非危险品，但勿入口和眼。
- 2、本品无毒，具有良好的生理惰性，对皮肤无刺激和伤害。产品不含有易燃易爆成份，不会引发火灾及爆炸事故，对运输无特殊要求。
- 3、本产品不宜在高温 250℃长期使用，可在-60℃~200℃持续使用。

#### 六、包装规格、贮存及运输

- 1、1 kg/罐，25kg/塑料桶，也可根据用户需要商定。
- 2、本产品贮存于干燥阴凉处，保存期为 1 年。
- 3、本产品为非危险品，可按一般化学品运输。

#### 七、建议和声明

建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性，我们公司不担保特定条件下使用我司产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失的责任，用户在使用过程遇到什么问题，可联系我公司售后服务部，我们将竭力为您提供帮助。